

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-051

天津金海通半导体设备股份有限公司

2026 年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本期业绩预告适用于“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上”的情形。
- 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 16,000 万元到 19,000 万元，同比增加 110.51%到 149.98%。
- 预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,700 万元到 18,700 万元，同比增加 112.70%到 153.34%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 16,000 万元到 19,000 万元，与上年同期相比，将增加 8,399.45 万元到 11,399.45 万元，同比增加 110.51%到 149.98%。

2、预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,700 万元到 18,700 万元，与上年同期相比，将增加 8,318.59 万元到 11,318.59 万元，同比增加 112.70%到 153.34%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：8,579.74 万元；归属于母公司所有者的净利润：7,600.55 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,381.41 万元。

（二）每股收益：1.32 元。

三、本期业绩预增的主要原因

2026 年上半年，受 AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域的驱动，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求持续增长，叠加公司全球化业务布局成效逐步显现，境外市场订单较上年同期实现较好增长。因此，2026 年上半年，公司产品测试分选机销量实现较大提升，公司业绩实现较好的增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日